

迎接新世代的新挑戰 - 用 AI 設計 AI 晶片

Encountering to New Challenges in a New Era-Designing AI Chips with AI

新世帯のチャレンジを迎える—AI で AI チップをデザイン



與會貴賓合影 (由左至右為:新思科技魏志中策略總監、國研院台灣半導體研究中心莊英宗副主任、科管局王永壯局長、新思科技全球李明哲副總裁暨臺灣區總經理、台灣新竹科學園區產學訓協會溫環岸副秘書長、新思科技賴吉昌總監)

文・圖 / 企劃組 曾宥璋

由科管局主辦，台灣新竹科學園區產學訓協會承辦之「迎接新世代的新挑戰 - 用 AI 設計 AI 晶片」論壇於本(2020)年8月18日在竹北喜來登大飯店盛大登場。科管局王永壯局長親臨致詞表示，在5G的推波助瀾之下，AI晶片也從過去以訓練為主的伺服器端的晶片，慢慢走向以推論為主的邊緣運算，惟AI的應用領域極廣，小從針對超低功耗 always on 的智慧家庭 AI 物聯網裝置，到強調高效能具備影像即時辨識工廠自動化、智慧監控以及自動輔助駕駛等應用，面對功耗、成本與效能所需要的系統設計考量完全不同，也大幅增加了AI晶片設計的複雜度，希望藉由本次論壇，增進大家對AI晶片設計技術發展及產業趨勢的了解。

本次論壇特邀請台灣新思科技協辦，並由李明哲總經理

開場，該公司魏志中策略總監 (Kevin Wei) 以「探索新世代智慧晶片設計與挑戰」為題、以及賴吉昌研發總監針對「嵌入式視覺的深度學習加速器 (Deep Learning Acceleration for Embedded Vision)」進行專題演講外，此外特別邀請到聯發科梁伯嵩處長分享人工智慧運算新趨勢，以及工研院資通所盧俊銘組長就 AI 系統晶片所需要的軟硬體協同設計與驗證分享他寶貴的經驗。

現場吸引了約110位園區廠商代表及學研機構等專業人士參與，足見各界對AI晶片設計及其趨勢的重視。藉由本次論壇，使國內產、學、訓、研等各界相互激盪，構思未來更好的人工智慧半導體創新應用，並帶動相關產業整體性成長，為臺灣半導體產業再造高峰。